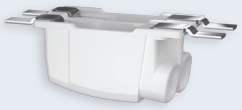
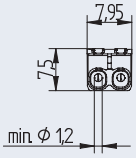
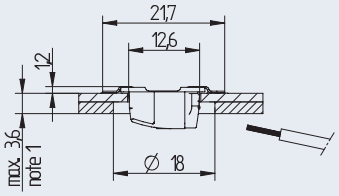
SMD-Leiterplattenklemmen

46.112 · SMD-Leiterplatten-Durchsteckklemme - Slim

technology for light

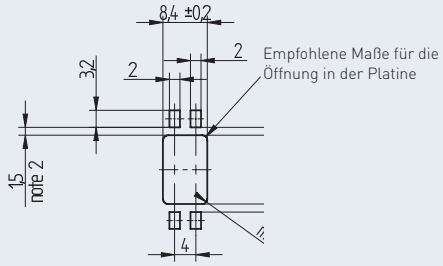






Anmerkung / note 1: Die maximale Paketdicke von Platine und Kühlkörper sollte 3.6 mm nicht überschreiten.

Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden



Anmerkung / note 2: Die einzuhaltenden Luft- und Kriechstrecken müssen abhängig von der Anwendung berücksichtigt werden.

SMD-Leiterplatten-Durchsteckklemme mit Steckkontakten

1-polig - 46.111.1001.50

Direktes Stecken von eindrähtigen und feindrähtig, verzinnten Leitern

Leiter durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen lösbar

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte unterseitig

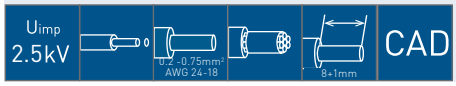
Vorschaltgerät und Leiterplattenklemme auf einer Ebene

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNiSiP
Kontakoberfläche: feuerverzinnt

Daten zur Verpackung 46.111.1001.50	
Gewicht SMD-Klemme	1.0 g
Anzahl Klemmen pro Spule	700 Stück
Durchmesser der Spule	381 mm - 15"
Gewicht pro Spule	1.26 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	10 Stück
Anzahl an SMD-Leiterplatten-klemmen pro Karton	7.000 Stück
Gewicht pro Karton	10.85 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 415 mm



Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.2 - 0.75 mm², AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnte Leiter	0.2 - 0.5 mm², AWG 24-20
Abisolierlänge	8 +1 mm
Leitereinführung	0 - 10°
Leiterlösefunktion mittels	Drehen und Ziehen
Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm²	min. 10 N
0.34 mm²	min. 15 N
0.5 mm²	min. 20 N
0.75 mm²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	4 mm / 0.157 inch
Breite	7.95 mm / 0.31 inch
Höhe	7.5 mm / 0.295 inch
Tiefe	21.7 mm / 0.85 inch
Spulendurchmesser Gurtverpackung	330 mm (13")
Gurtbreite	32 mm
Pitchabstand	16 mm
Verpackungseinheit Tape-and-Reel	500
Verpackungseinheit Karton	5.000 (10 Spulen)

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	CuNiSiP
Kontakoberfläche	feuerverzinnt

Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte unterseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

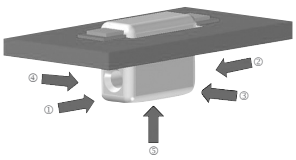
Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120°

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp FR4 1.0 mm	
Bemessungsspannung (III / 3)	200 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp IMS	
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977	
Bemessungsspannung UL 1977	320 V
Bemessungsstrom UL 1977	USR 9 A, AWG 24 -18 CNR 6 A, AWG 24-20 CNR 9 A, AWG 18

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE ENEC	EN 60947
UL	cURus, File No. E-365006

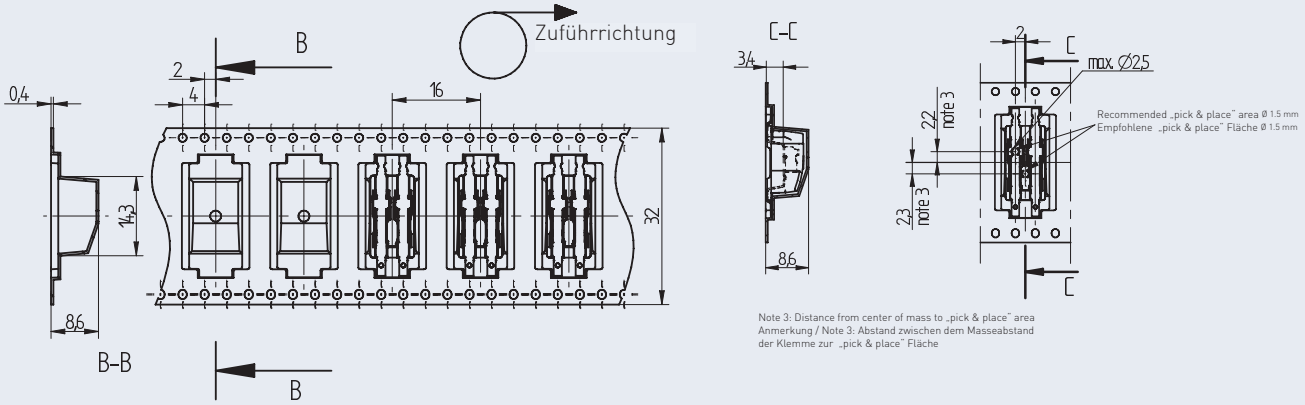
Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007. Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
Richtung 1 Scherkraft längs	160
Richtung 2 Scherkraft längs	100
Richtung 3 Scherkraft quer	30
Richtung 4 Scherkraft quer	30
Richtung 5 Abzugskraft	30

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C.
Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	**Reflow-Profil** (bleifreies Löten): T_{max} = 260 °C, t_{max} < 10 sec, 2 - 3,5 K/s, 2 - 3,5 K/s, $T_L \geq$ 230 °C, t_L: 20 - 60 sec, 1,5 - 2,5 K/s, T_s: 150 °C - 180 °C, t_s: 60 - 120 sec
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150)

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.